



Thin Film Planar Filters

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		15.0		GHz
工作频率		/		GHz
中心损耗		6.5	7.0	dB
带内波动		/		dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-14.4GHz	38	43		dBc
带外抑制@15.6-24.0GHz	38	43		dBc
承受功率			20	dBm
工作温度	-55		+85	°C
储存温度	-55		+125	°C

口厚板 Rogers5880, h: 0.254mm	电路板 Rogers43503, h: 0.254mm
-----------------------------------	------------------------------------

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 ($6.7\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$)，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配；

Email:pengxiaojun@cdsprs.com

邮箱 sales@com-mw.com

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。